



Metals Focus 金属聚焦

贵金属周报

第 658 期
2026/06/08

黄金

5月底，美国对伊朗发动新一轮打击令和平前景蒙上阴影，并使美联储加息担忧继续成为市场关注焦点，金价跌至4400美元/盎司下方，降至两个月低点。

白银

5月底，金银比继续于60附近横盘整理。

铂金

5月底全球铂金交易所交易产品（ETP）持仓量降至311万盎司，为2024年4月以来最低水平。

钯金

4月份欧盟汽车销量同比增长5.1%，至97.2万辆，其中新能源汽车销量增长18%，燃油车销量下降17%。

黄金电子业需求：从一般用途转向关键赋能

近年来黄金价格大幅上涨对全球电子制造业的成本结构形成显著压力。来自我们工业领域联系人的反馈显示，该行业正经历一场以重新调整黄金使用策略为核心的结构性转型。这并非单纯的成本管理举措，而是对材料选择和工艺设计的根本性重构，旨在维持长期竞争力。

为应对持续的材料成本通胀，电子行业制造商根据终端应用对可靠性的要求采取了不同策略。

在消费电子和标准内存模块等成本敏感型市场，减金措施已得到广泛实施。举例来看，电路板制造商正加快从传统化学镀镍浸金（ENIG）工艺向钯-金复合工艺（ENEPIG）转型。从实际应用看，这一转变可在铜基底上沉积更薄且控制更精准的金属层，在保持功能完整性的同时大幅降低单位黄金用量。相对于覆盖整个表面的镀金技术，引线框架生产商也已采用选择性电镀技术，仅在关键触点镀金，从而显著节省材料用量。

半导体封装中金键合线的替代也遵循了类似路径。尽管黄金传统上一直是高可靠性互连材料的首选，但正日益被铜、铜镀钯（PCC）和银合金等替代材料所取代。行业数据显示，这一趋势在大批量消费电子和通用型微控制器生产中最为显著。



Metals Focus 感谢其合作单位——中国黄金协会
对《贵金属周报》中文版的支持



Metals Focus感谢下列机构对《贵金属周报》中文版的支持



www.valcambi.com



A PALLION COMPANY

www.ABCbullion.com



Bulmint

www.bulmint.com



www.randrefinery.com



PRESTIGE
BULLION

www.realkruggerand.com



MENNICA
POLSKA

ISTNIEJE OD 1766 R.

www.invest.mennica.com.pl



www.axedras.com

Miller

www.miller-insurance.com

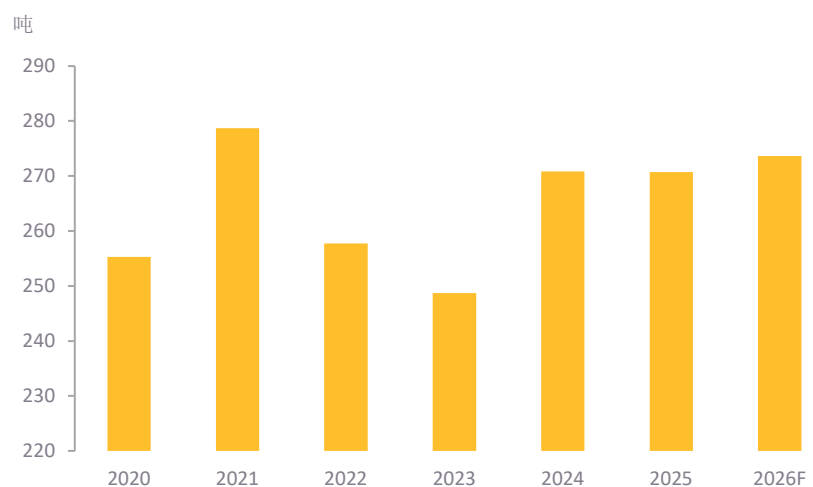
高可靠性应用领域的情況截然不同，与上述趋势形成鲜明对比。AI服务器基础设施、汽车电子和先进光通信模块等领域对信号完整性和组件寿命有着严格要求。这些领域用金量依然坚挺，在部分规格中甚至有所增加。

内存标准向HBM4（高带宽内存）的过渡正体现了这一趋势。随着芯片堆叠密度上升到新水平，镀金厚度规格已由此前的2~3微米上调至5~8微米，同时纯度要求也更为严格。其战略考量显而易见：在超高性能系统中，由互连接口稳定性不足引发的系统级故障风险会造成灾难性隐患，其影响远非材料替代所带来的边际成本节约可比。

硅光子技术和共封装光学（CPO）商业化落地成为另一关键焦点，相关技术于2026年进入关键部署阶段，将基于光的数据传输直接集成至芯片封装中，在显著提升AI数据中心数据吞吐量同时也降低了能耗。

对于黄金市场而言至关重要，这种混合光电集成趋势对信号衰减异常敏感，因此相关基板和引线框架必须采用高纯度镀金，其结果便是共封装光学技术的快速普及正创造出重要的新增需求来源。

黄金电子业需求量



数据来源：Metals Focus五年期季度预测报告

低轨卫星（LEO）市场快速扩张及汽车领域对激光雷达（LiDAR）和4D成像传感器的需求增长进一步强化这一趋势。这些领域持续带动化合物半导体组件出货量强劲增长。与标准商用部件相比，此类组件对热管理和可靠性的要求更为严苛，因此所需背面金属化镀金层厚度显著高于行业平均水平。

黄金在半导体封装领域的角色正在发生战略性转变。随着芯片堆叠技术和异构集成成为行业标准，微凸点镀金和晶圆背面金属化等工艺正消耗越来越多的高纯度黄金。这一“功能性升级”确保即使传统金线用量因替代效应而下降，电子领域黄金消费整体仍具韧性，其发展方式是向更复杂的结构演进，而非简单的规模收缩。

总体来看，电子领域正面临双重现实情况。一方面，消费级电路板、标准引线框架和通用封装键合线等传统黄金应用支柱正经历系统性的单位用量下降变革。随着替代技术持续成熟、替代材料渗透率不断提升，这一趋势短期内不太可能逆转。而另一方面，高可靠性应用带来的增长预计将超过上述需求降幅。其中重要之处在于，上述新兴应用中的黄金使用具有单位用量更高、规格要求更严格、对价格波动敏感度相对较低等特点。

展望未来，能够成功掌握精密镀金、薄膜工程及高性能应用严格可靠性认证的制造商有望在竞争中获得优势。电子领域围绕黄金需求的叙事正发生演变，从主要以规模为核心日益转向质量和精度定义模式。鉴于这一转型仍处于早期阶段，因此在未来数年内，其对工业用金需求的影响将持续显现。



Metals Focus - 全球办事处

伦敦 | 新加坡 | 上海 | 孟买 | 台湾 | 香港 | 伊斯坦布尔 | 马尼拉 | 约翰内斯堡

商务信息与合作请联络:

Charles de Meester, 董事总经理
charles.demeester@metalsfocus.com
+44 7809 125 334

Neelan Patel, 销售总监
neelan.patel@metalsfocus.com
+44 7783 448 891

Metals Focus - 联系方式

地址
6th Floor, Abbey House
74-76 St John Street,
London EC1M 4DT
U.K.

电话: +44 20 3301 6510
邮箱: info@metalsfocus.com
彭博Metals Focus主页: MTFO
彭博聊天: IB MFOCUS
www.metalsfocus.com



MetalsFocus 金属聚焦
微信扫描二维码, 关注我们公众号

免责声明与版权声明

除非另有说明, 本报告中所有知识产权的拥有人或持牌人均均为Metals Focus Ltd。本报告(包括任何附件和附件)是为收信人独家使用而编写的。本报告中任何内容均不构成购买或出售贵金属或相关证券或投资的要约, 也不构成关于购买或出售贵金属或相关证券或投资的建议。在根据本报告的内容采取(或不采取)任何行动之前, 您必须获得专业或专家的建议。虽然我们已尽一切努力提供在本报告中公布的信息, 但Metals Focus Ltd并不保证其内容的准确性或通用性。本公司对任何错误或遗漏概不负责, 亦不对任何损失或损害承担任何责任, 亦不对任何第三方承担任何责任。

本报告(包含本报告的任何部分)不得在未经Metals Focus明确书面同意的情况下复制、分发、传输或传达给任何第三方。本报告以电子方式提供, 只有已获发个人用户牌照的获授权用户, 才可下载本报告的副本。如有需要, 可向Metals Focus Ltd购买额外的用户许可证。任何未经授权的工作行为可能导致民事或刑事诉讼。